

胡志明市國家大學半導體與晶片領域研究生可獲企業學費補助

駐胡志明市辦事處教育組

為回應半導體技術與晶片設計領域對高階專業人力日益迫切之需求，胡志明市國家大學近日公佈，修讀半導體科技與晶片設計相關研究所課程之碩、博士生，將有機會獲得企業全額或部分學費補助。

據了解，一家越南國內企業基於半導體產業發展需求，對於在胡志明市國家大學體系內攻讀半導體科技及晶片設計相關領域之研究生提供學費補助，並對其修業進度及科研成果提出明確且嚴謹之要求。

胡志明市國家大學所屬自然科學大學近日公布 2025 年度研究所獎學金計畫，該計畫由 CT Group 集團贊助，旨在培育半導體科技與晶片設計領域之高階專業人才。該獎學金對象為胡志明市國家大學體系內攻讀研究所課程之碩、博士生，並於標準修業年限內適用。相關獎學金經費將直接撥付予各培訓單位，用以繳納學費。

依據規劃，博士生於三年標準修業年限內可獲全額（100%）學費補助；碩士生則於兩年標準修業期間內獲得 50%學費補助。另對於 2025 年度研究所招生中，符合規定得以直接錄取之學生，將提供全額學費補助。申請獎學金者不得同時領取胡志明市國家大學或其成員學校所提供之其他獎學金，並須承諾履行完整之學業責任與修課義務，確保於規定之標準年限內完成學業（博士三年、碩士兩年）。

碩士生之申請對象須為 2025 年入學，且就讀半導體科技、晶片設計或相關專業領域；符合胡志明市國家大學逕行錄取規定者，將優先納入評選。在科研成果方面，碩士生須至少符合下列條件之一：於 Web of Science 或 Scopus 收錄之期刊發表或獲接受刊登一篇論文；或於具審查制度之國際研討會或國外學術期刊發表兩篇論文；或參與並完成各級科研計畫；或擁有經國內或國際認可之智慧財產權成果或技術解決方案。

博士研究生則須為 2024 年或 2025 年入學，且研究主題屬於半導體科技或晶片設計領域。其科研成果須至少包含三項經 Web of

Science、Scopus 或同等級資料庫收錄之學術論文或會議論文，其中至少一篇屬 Q2（Quartile 2）等級以上；或擁有於國內或國際獲認可之專利或智慧財產權成果。

此外，所有獲補助之研究生均須依校方要求，提供真實、完整且透明之學習歷程、科研成果及畢業後就業情況相關資訊。該獎學金申請資料受理期限至 2025 年 12 月 27 日止。

撰稿人/譯稿人：林韋至

資料來源：2025 年 12 月 23 日，年輕電子報；

<https://tuoitre.vn/hoc-nganh-ban-dan-vi-mach-tai-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-duoc-tai-tro-hoc-phi-sau-dai-hoc-2025122310590011.htm>

